



LOTPASTE SC 180

RE L0; Typ ISO 1.2.3.C

Die Lotpaste SOLDER CHEMISTRY SC 180 ist ein Spitzen High-Tech-Produkt, das für die aller- neuesten SMT-Anwendungen bestens geeignet ist. Langjährige Erfahrung auf dem SMT-Gebiet und fundierte Kenntnisse in der Kunststoffchemie haben zu einer vollständigen und zukunftsweisenden Entwicklung beigetragen.

Die SC 180 ist, wie alle SMT-Lotpasten, eine gleichmäßige Mischung aus einem Weichlotpulver, in allen erforderlichen Legierungen und Körnungen lieferbar, mit einem organischen Bindemittel auf synthetischer Harzbasis, das der RE L0 nach J-STD-004 oder ISO 1.2.3.C entspricht; **absolut halogenfrei(!)** und dadurch zu den neuesten und allerbesten "no-clean"-Pastentypen gehört.

Außer der hervorragenden Konturenstabilität, absolut keiner Lotkugel- oder Spritzerbildung, einer langzeitigen Verarbeitbarkeit und langen Lagerzeit, sowie hoher Temperaturstabilität, zeichnen diese Paste folgende Vorteile aus:

SC 180 Glasantiger, geringer (4,3%) Rückstand, begünstigt den "in-circuit"-Test !

SC 180 Eine echte "synthetische" Paste

SC 180 Eine hervorragende Druckqualität, von der ersten Rakelbewegung an, mit beliebigen Zwischenstops

SC 180 In allen geschlossenen Rakelsystemen, wie Proflow , Rheomatic Pumphead, Puck Pack und Crossflow bestens anwendbar

SC 180 Auch für "ultra super fine-pitch" Anwendungen bestens geeignet

SC 180 Exzellente Lötresultate mit allen gängigen Lötprofilen und Lötanlagen

SC 180 Die Kunststoffbasis garantiert keine teerartige Verschmutzung ihrer Lötanlage

PHYSIKALISCHE DATEN

Metallpulver: bevorzugte Legierungen 62Sn\36Pb\2Ag (SP-179°C), 63Sn\37Pb (183°C) und 10Sn\88Pb\2Ag (SB 268-302°C)

Bezeichnung der Korngröße

nach SC	nach DIN 32 513	Durchmesser	mesh size
Fein (T3)	Klasse 3	20-45µm	325-500
Superfein (T4)	Klasse 4	15-30µm	400-700

VISKOSITÄT (Pa.s) +/-10% gemessen nach Brookfield DV-II Viskosimeter bei 90% Metallgehalt

Korngröße	Viskosität
Fein (T3)	600-800

OBERFLÄCHENWIDERSTAND (SIR) und elektrolytische Korrosionswirkung nach DIN 32513

Messungen am	4.Tag	<u>21.Tag</u>
	3,2x10 ³	5,3x10 ³

QUALIFIKATIONEN

Die Lotpaste SC 180 ist eine RMA-Paste die den Anforderungen der DIN, ISO, EN und MIL-QQ-S571e entspricht. Der Korrosions-, Lotkugel- und der Benetzungstest sowie die Konturenstabilitätsprüfung (nach SN 59650) wurden bestanden. Laboruntersuchungen bestätigen korrosionsfreie, der RE L0 „no-clean“ (F-SW33) entsprechende, Rückstände, die auf der Leiterplatte bedenkenlos verbleiben können, auch unter dem Schutzlack.

VERBRAUCHERHINWEISE

Nach Entnahme der Paste, das Gebinde möglichst dicht verschließen. Die benutzte Paste soll nicht mit der frischen zusammen aufbewahrt werden. Im laufenden Arbeitsprozess darf selbstverständlich neue Paste der älteren zur Auffrischung zugeführt werden. Verschiedene Lotlegierungen und Pastentypen sollte man nicht vermischen.

Empfohlene Rakelgeschwindigkeit: 15-150mm/s.

Merke! Der Pastendruker ist immer schneller als der schnellste Bestücker in Ihrer Linie. Das wichtigste ist, daß die Paste beim Drucken am Rakel abrollt.

Für Schablonendruck wird eine Paste mit 90% Metallgehalt empfohlen

Die Reinigung der Schablone kann mit einer Alkoholmischung erfolgen, aber das Reinigungsmedium darf unter keinen Umständen mit der Paste in Verbindung kommen.

Deswegen empfehlen wir den **SC Schablonenreiniger**.

Die Lotpaste ist in allen gängigen Reflow-Systemen mit exzellenten Lötgergebnissen zu gebrauchen.

LAGERUNG

Ungeöffnetes Gebinde bei ca. 20°C (RT) : 6 Monate. **Eine Lagerung im Kühlschrank ist nicht notwendig!**

Im geöffneten Zustand bzw. am Rakel der Druckeinrichtung wird leicht eine 16-stündige Verarbeitungszeit erreicht. Doch obwohl die Paste fast absolut gegen Umwelteinflüsse immun ist, können besonders schwere Klimabedingungen, wie sehr trockene Luftzüge oder eine extrem hohe relative Luftfeuchtigkeit (über 90%), die Verarbeitungszeit bemerkbar verkürzen. Die Topfzeit dagegen, ein dichtes Abschließen der Dose wird vorausgesetzt, kann mehrere Wochen betragen.

So bestellen Sie Ihre Solder Chemistry Pasten

Legende	Pastentyp	Korngröße	Legierung	Flußmittelanteil	Gebindegröße
z.B.	SC 180	T3	62/36/2Ag	10%	500g
	SC 180	T3	63/37	10%	200g

Bestellbeispiel nach DIN:

Lotpaste(SC...) L-Sn62Pb2Ag / F-SW 33 / 90-3 200g(Gebinde)

Solder Chemistry ; Fragnerstraße 4 ; D-84034 Landshut
Tel. ++49/871/4309500 ; Fax. ++49/871/43095020
e-Mail: info@SolderChemistry.com ; www.solderchemistry.com